



连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > PCB D-Sub 连接器



连接器和壳体类型: 母端, 母端

位数: 80

中心线 (间距): 1.27 mm [.05 in]

行数: 2

行间距: 1.9 mm [.075 in]

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	80
行数	2
PCB 安装方向	垂直

主体特性

屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	钢
外壳电镀材料	镍
主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

	30 μin
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.012 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.015 in]
端接柱体和尾部长度的	3.1 mm[.122 in]

机械附件

安装孔直径	2.8 mm
PCB 安装固定	不带
接合固定	带有
接合固定类型	释放锁
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	1.27 mm[.05 in]

尺寸

面板厚度 (建议值)	2.01 mm[.079 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.062 – .093 in]
行间距	1.9 mm[.075 in]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	6
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月 (201) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <

900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

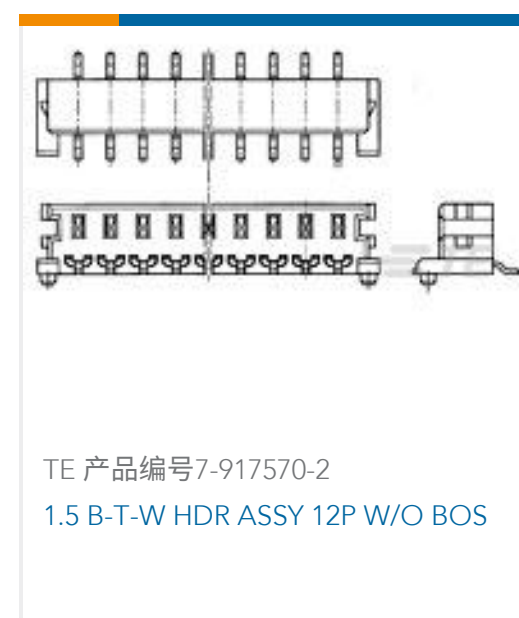
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5175887-0_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5175887-0_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5175887-0_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。



产品规格

CHAMP 050 II Shield Case Kit (Original Type)

英文版本

应用规格

英文版本